



ニュースリリース

平成21年11月11日

“世界最小” 対向式TWINスピンドル搭載セミオートダイサ「AD20T」の納入開始

株式会社東京精密（代表取締役社長：藤森一雄）は、電子部品に代表されるLED、ディスクリートなどの小チップデバイスや、QFN/BGAなどのPKGデバイスのダイシングにおいて、従来機比で最大2倍の高スループットと、40%の省フットプリントを実現した、“世界最小” TWINスピンドル・セミオートダイサ「AD20T」^{※1}の納入を開始しました^{※2}。

<背景>

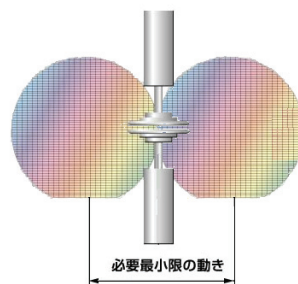
電子部品に代表されるLED、ディスクリートなどの小チップデバイス、QFN/BGAなどのPKGデバイスでは、イニシャルコストの低いセミオートダイサを使用するのが一般的でした。しかしながら、近年の低価格化の要求により、処理時間の短縮化と、限られたクリーンスペースを有効活用し、低COO（Cost of Ownership）を追及した投資効率の高いセミオートダイサを求めるニーズが高まっております。

東京精密では、このような市場要求をいち早く察知し、対向式TWINスピンドル^{※3}による高スループットと世界最小のフットプリントを実現した「AD20T」の開発を完了し、販売、納入を開始しました。

「AD20Tの特徴」

- ・ 高スループット

TWINスピンドルを搭載した「AD20T」では、2本スピンドルでの同時ダイシングが可能となり、シングルスピンドル機に対して、最大で2倍の高スループットを実現しました。



- ・ 世界最小のフットプリント

当社のコア技術を駆使し、無駄なスペースを徹底的に省いた先進的なレイアウト構成はTWINスピンドル搭載機でありながら、従来機比で40%という圧倒的な小フットプリント化を達成できました。特許出願中。

株式会社東京精密

東京都三鷹市下連雀 9-7-1 〒181-8515 TEL. 0422-48-1011

- ・ 高い加工対応力

省フットプリントながら、「AD20T」は最大系φ200mm、250mm角までのワークサイズに対応します。また、専用に開発した新型スピンドルと装置バランスの最適化により、業界トップレベルの加工パフォーマンスを発揮します。

TWINSピンドルによる、柔軟な加工アプリケーションへの対応も「AD20T」の大きな特徴です。各スピンドル軸に異なるブレードを装着し、ステップカットモードによる加工品質の向上、様々なワークへの対応が可能となります。

- ・ 操作性の向上

一新したGUI(Graphical User Interface)、17インチ・LCDタッチパネルを搭載し、使い易い操作性を実現しました。加工状況、各種ステータスをオペレータが直感的に理解できるようビジュアル表示し、アイコン化されたボタンをタッチするだけで、簡単にダイレクト操作が行えます。



※1 2009年5月よりテストカットを開始、2009年8月より販売を開始した。

※2 2009年10月時点で、相当数の受注を頂いている。

※3 1999年に東京精密が世界で初めて量産化に成功した方式

以上